证券代码：603005　　证券简称：晶方科技　　公告编号：临 2020-040

苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年5月22日向苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200668号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。

公司收到上述《反馈意见通知书》后，与相关中介机构对所列问题进行了认真核查和逐项落实。公司现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《苏州晶方半导体科技股份有限公司与国信证券股份有限公司关于非公开发行A股股票之申请文件反馈意见的回复》。公司将按照《反馈意见通知书》的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日